Description du produit

FINITION: CETTE PLATINE SERA IMMERSION GOLD PLATED SELON IPC-6012.
L'ÉPAISSEUR EST DE 0.505MM SUR LE NICKEL DE 3 à 6uM.

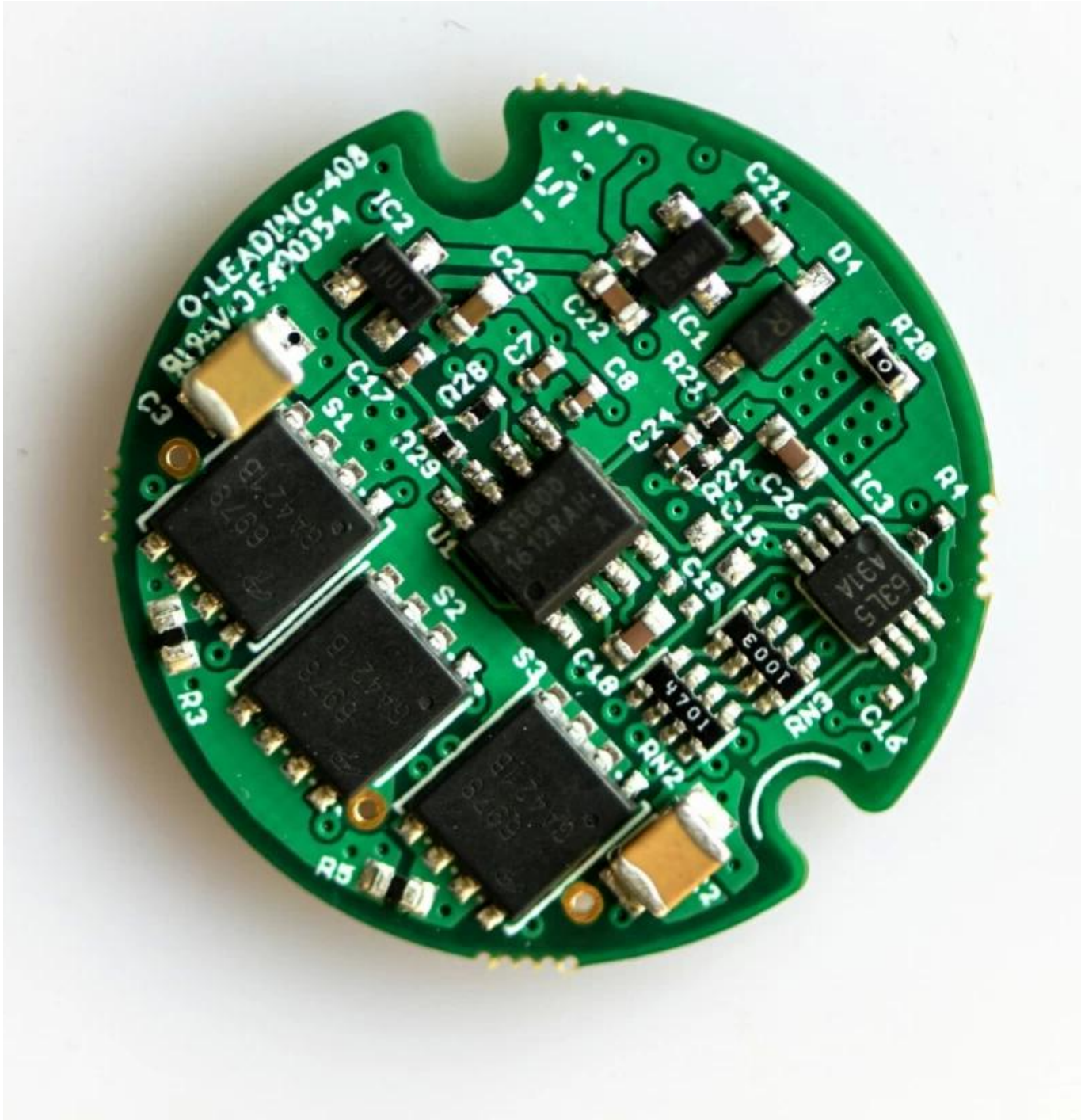
PLAQUETTE DE CUIVRE HOLS MINIMUM .025 AVG, .020 MIN .. LES FAISCEAUX NE PEUVENT PAS ÊTRE PLUGÉS

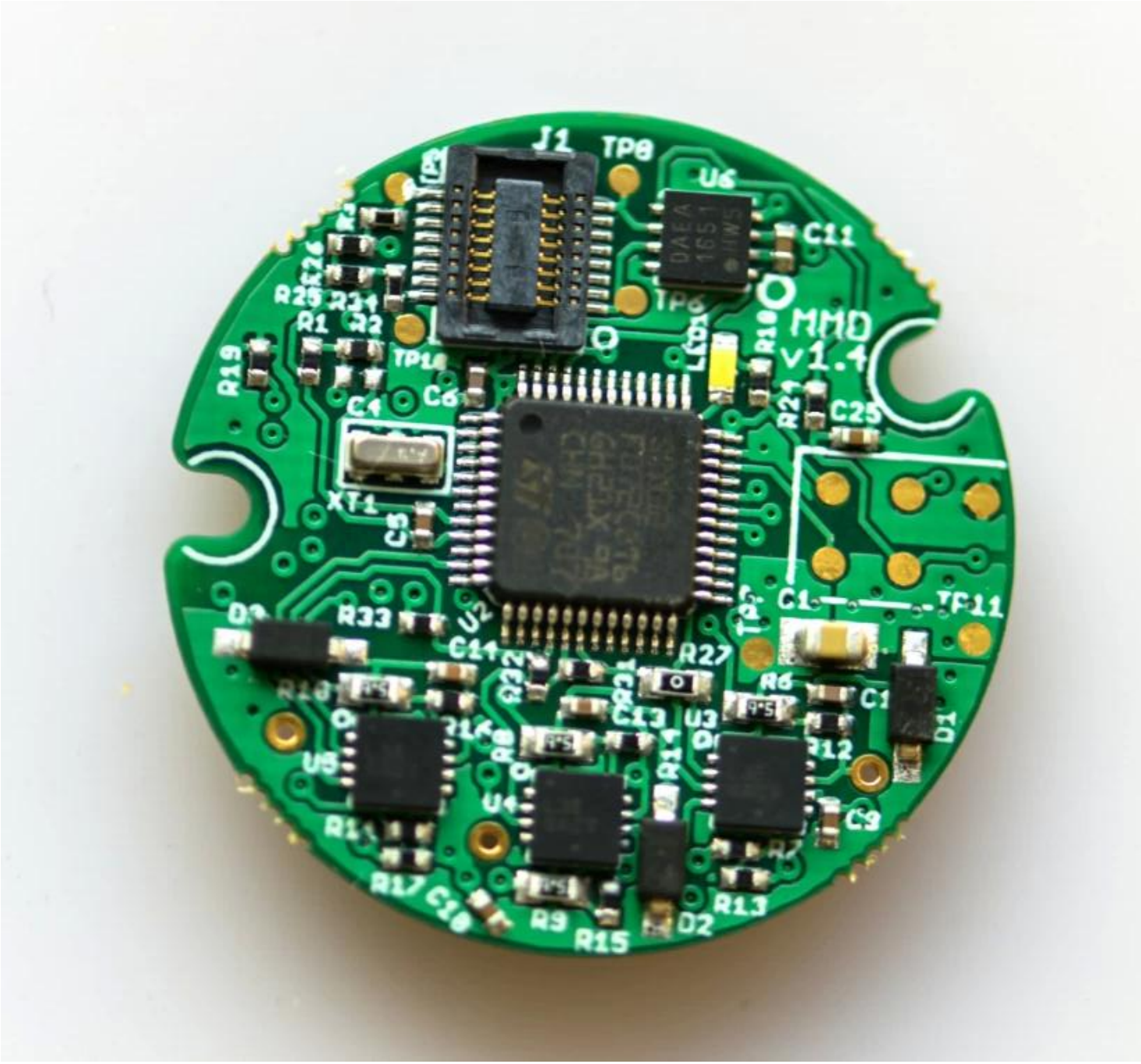
Pack avec un film incolore transparent à bulles, 25 PCS / sac, mettre un déshydratant dans un flanc, placer une carte indicateur d'humidité sur le dessus
Structure de couche

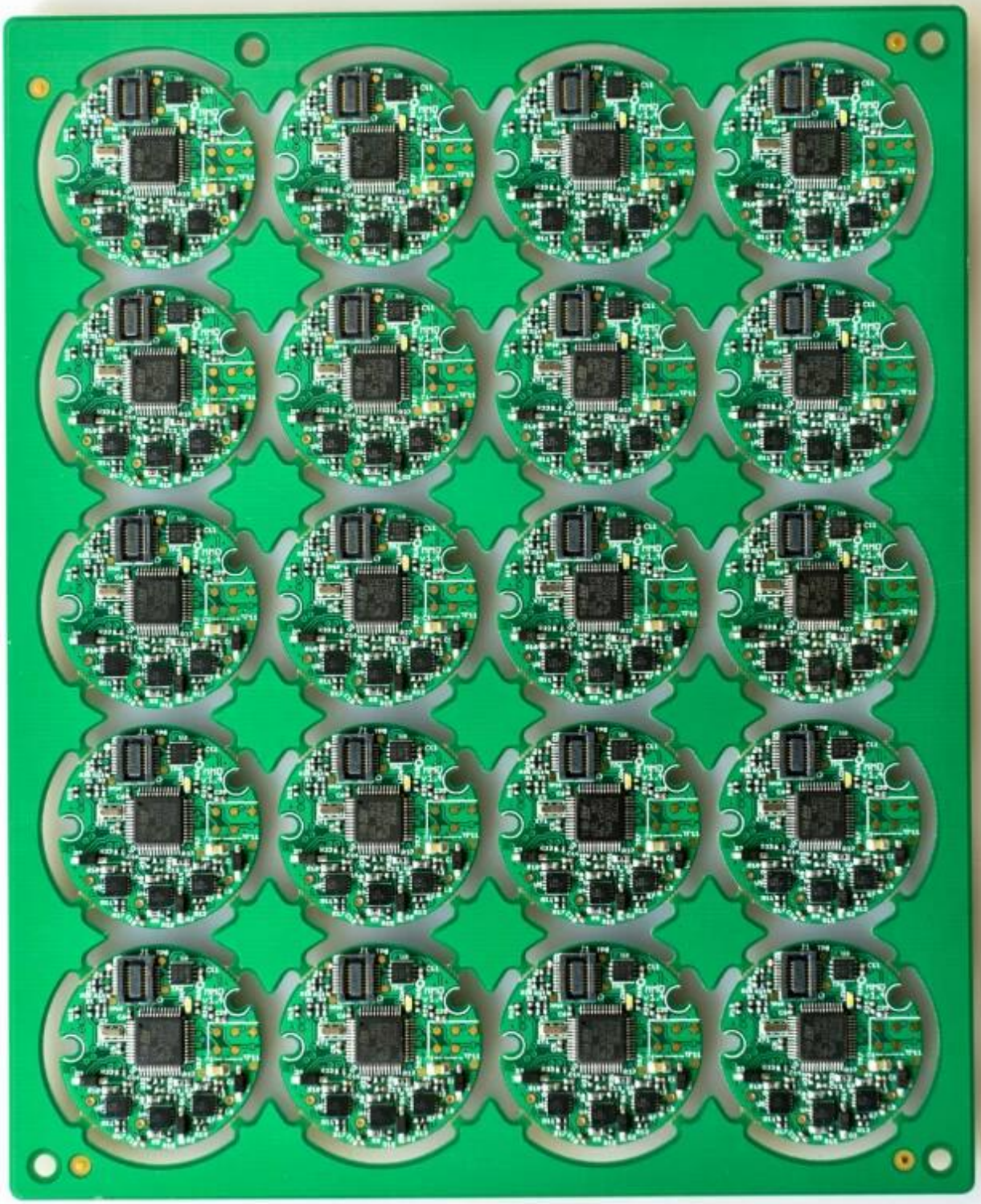
L1 ---------- HOZ
  - PP 7mil -
  - -
L2 ---------- 1OZ
  - CORE 9.05mil -
L3 ---------- 1OZ
  - -
  - PP 7mil -
L4 ---------- HOZ

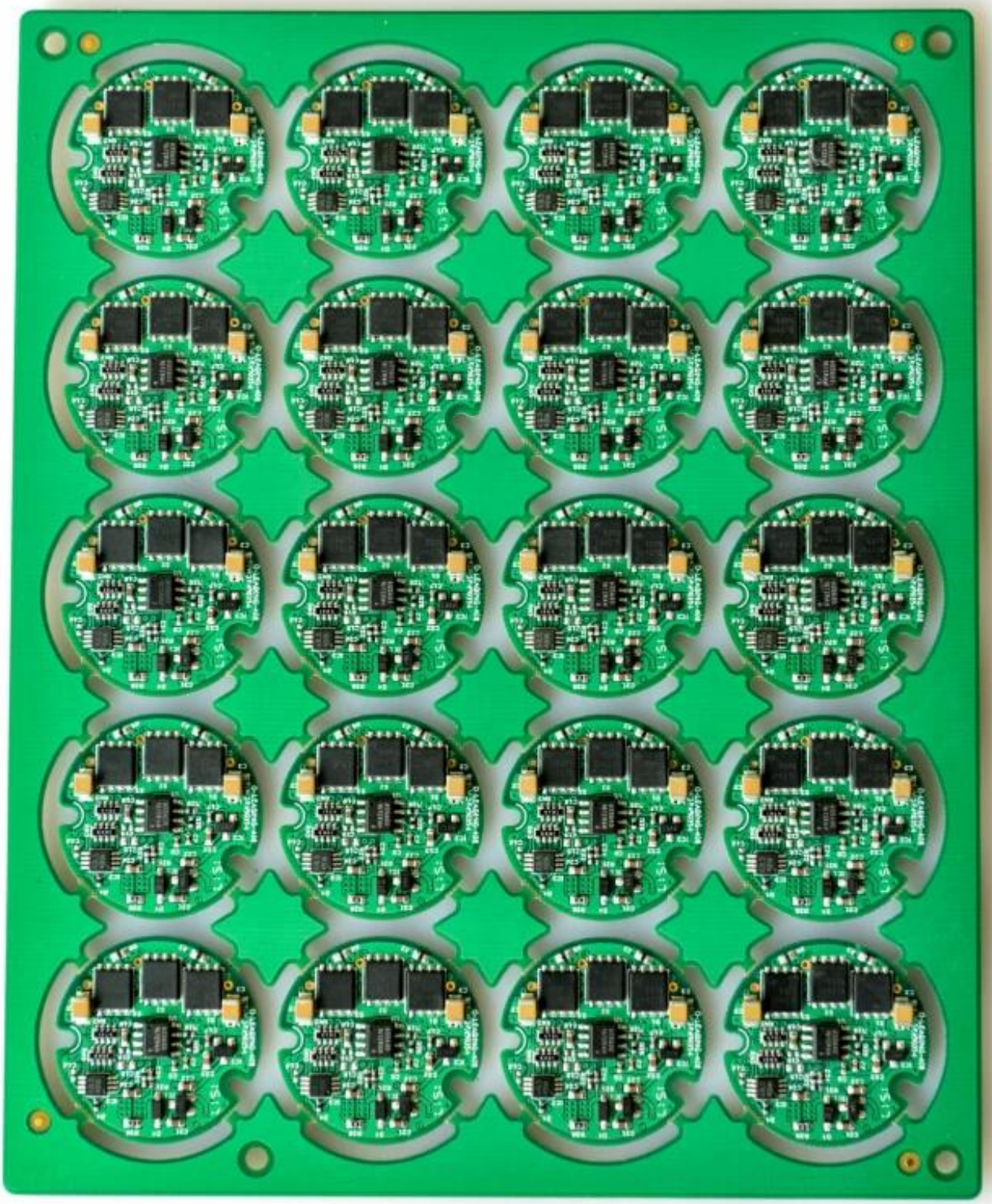
Définitions de la couche:

* .GCMT - Masque de revêtement supérieur
* .GTP - Top Solder Paste
* .GTO - Sérigraphie supérieure
* .GTS - Top Soldermask
* .GTL - Top Layer
---
* .G2L - Inner Signal Layer 1
==========
* .G3L - Inner Signal Layer 2
---
* .GBL - couche inférieure
* .GBS - Bottom Soldermask
* .GBO - Sérigraphie en bas
* .GBP - Pâte à souder inférieure
* .GCMB - Masque de revêtement conforme au bas


O-LEADING-408
IC2
C23
C22
C21
D4
IC1
R28
C7
C8
R21
C17
S1
R29
C24
R22
C26
IC3
R4
U1
C15
C19
S2
S3
C18
RN3
C16
RN2
R3
R5


J1
TP8
U6
C11
MMD
v1.4
R25
R34
R1
R2
R19
TP10
C4
C6
C25
XT1
C5
R33
C14
R27
C1
TP11
R6
C13
U3
D1
U5
U4
R12
C9
R17
C18
R9
R15
D2
R13





Fournisseur de carte de circuit imprimé, design Pcb en Chine